



Okamoto

株式会社岡本工作機械製作所
(証券コード：6125)

2022年3月期決算説明資料

2022年6月13日

アジェンダ

1. 2022年3月期 決算概況
2. 前中計「SHINKA2022」振り返り
3. 新中期経営計画 概要
4. 2023年3月 決算予想

Appendix

1. 2022年3月期 決算概況

決算サマリ

業績

- ✓ 売上高375億47百万円、営業利益40億81百万円
- ✓ 共に公表数字 (2021年5月13日) を上回り着地
- ✓ 売上高は過去最高を更新

受注実績

- ✓ 半導体関連装置は引き続き受注堅調
- ✓ 工作機械もウクライナ情勢の影響あるもコロナ禍からの回復局面で受注回復

市場概況

■ 国内市場

- 工作機械はものづくり補助金や事業再構築補助金などの経済政策や半導体業界の成長などを背景に回復局面。幅広い業界から汎用平面研削盤、大型平面研削盤、内面研削盤などの設備需要があり、好調に推移。年度後半からはロボット向けなど精密歯車の需要も高まる
- 半導体関連装置は、企業のデジタル化の促進、5Gスマートフォンの高機能化などに伴い半導体デバイスの需要強く引き続き堅調

■ 海外市場

- 北米市場は、金型業界向けの需要増加と航空機関連で回復の動き
- 欧州は経済活動の再開や自動車産業の復調による景気拡大でEV車向け平面研削盤の需要が高まる
- アジア市場では引き続き中国でのEV車関連の設備投資が活況。東南アジアもコロナ禍からの回復局面で設備投資活発。また東アジア向けウェーハ生産用のファイナルポリッシャーの販売が増加

業績ハイライト

* 「収益認識に関する会計基準」等を第1四半期連結会計期間の期首より適用
前第2四半期連結累計期間との増減額及び前年同期比（%）は記載せず

（単位：百万円）

| | 2021年3月 | 2022年3月 |
|------------|---------|---------|
| | 金額 | 金額 |
| 売上高 | 30,372 | 37,547 |
| 売上総利益 | 8,494 | 11,926 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,588 | 7,845 |
| 営業利益 | 1,905 | 4,081 |
| 経常利益 | 1,869 | 4,197 |
| 当期純利益 | 1,458 | 2,892 |

（単位：百万円）

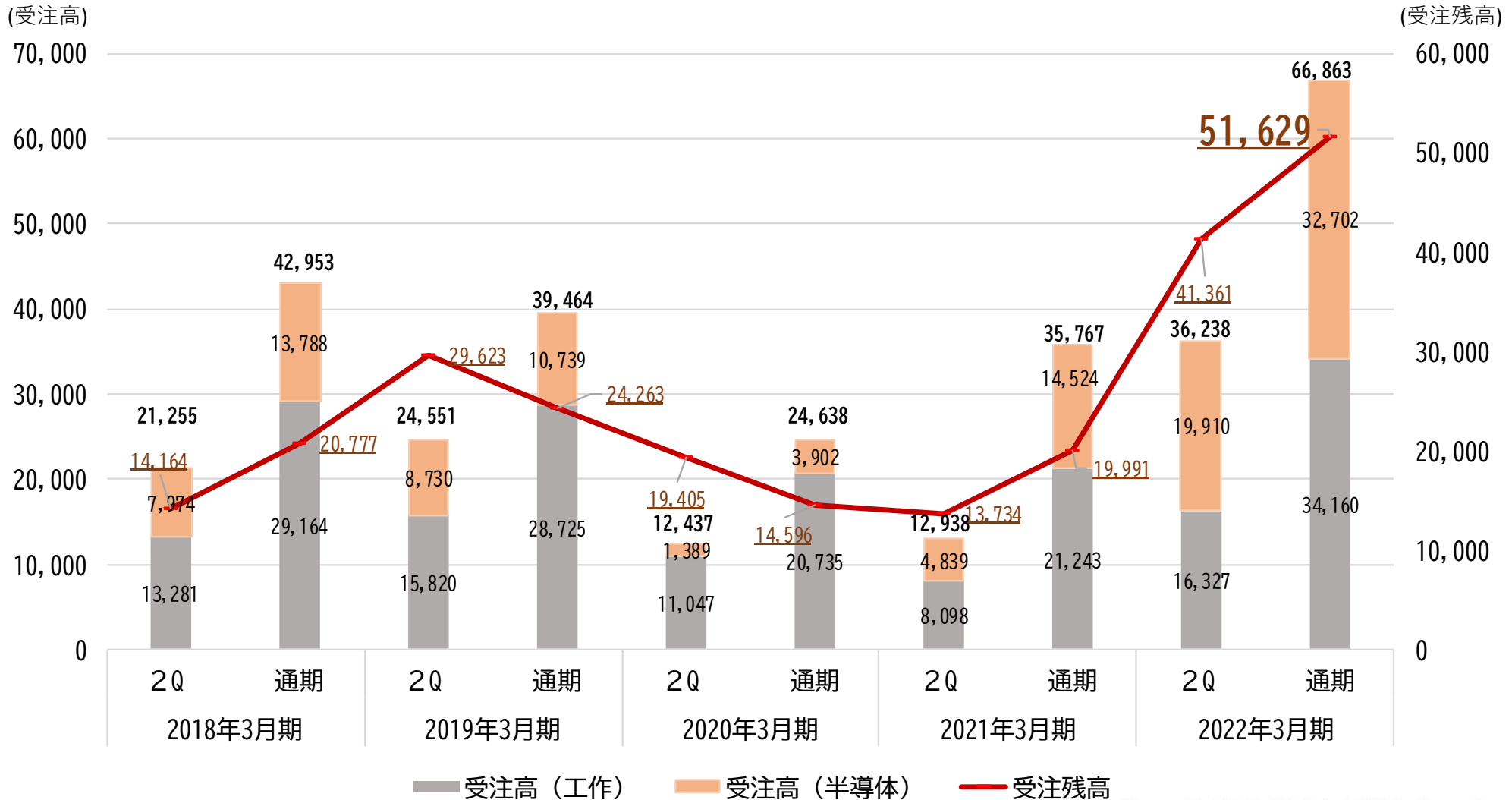
| | 2021年3月 | 2022年3月 |
|----------|---------|---------|
| | 金額 | 金額 |
| 設備投資額 | 946 | 1,536 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,418 |
| 研究開発費 | 115 | 95 |
| 為替レート | | |
| 米ドル | 105.94 | 113.04 |
| シンガポールドル | 77.76 | 83.83 |
| ユーロ | 124.07 | 131.11 |
| タイバーツ | 3.42 | 3.45 |
| 人民元 | 15.65 | 17.65 |

※期中の平均レートで記載しております。

- 売上高は375億47百万円（前期は303億72百万円）、営業利益は40億81百万円（前期は19億5百万円）
- 工作機械は半導体関連向けを中心に幅広い業界から設備需要があり回復継続局面、特に歯車が好調
- 半導体は旺盛な半導体需要により東アジア向けの販売が増加、前年度を上回る

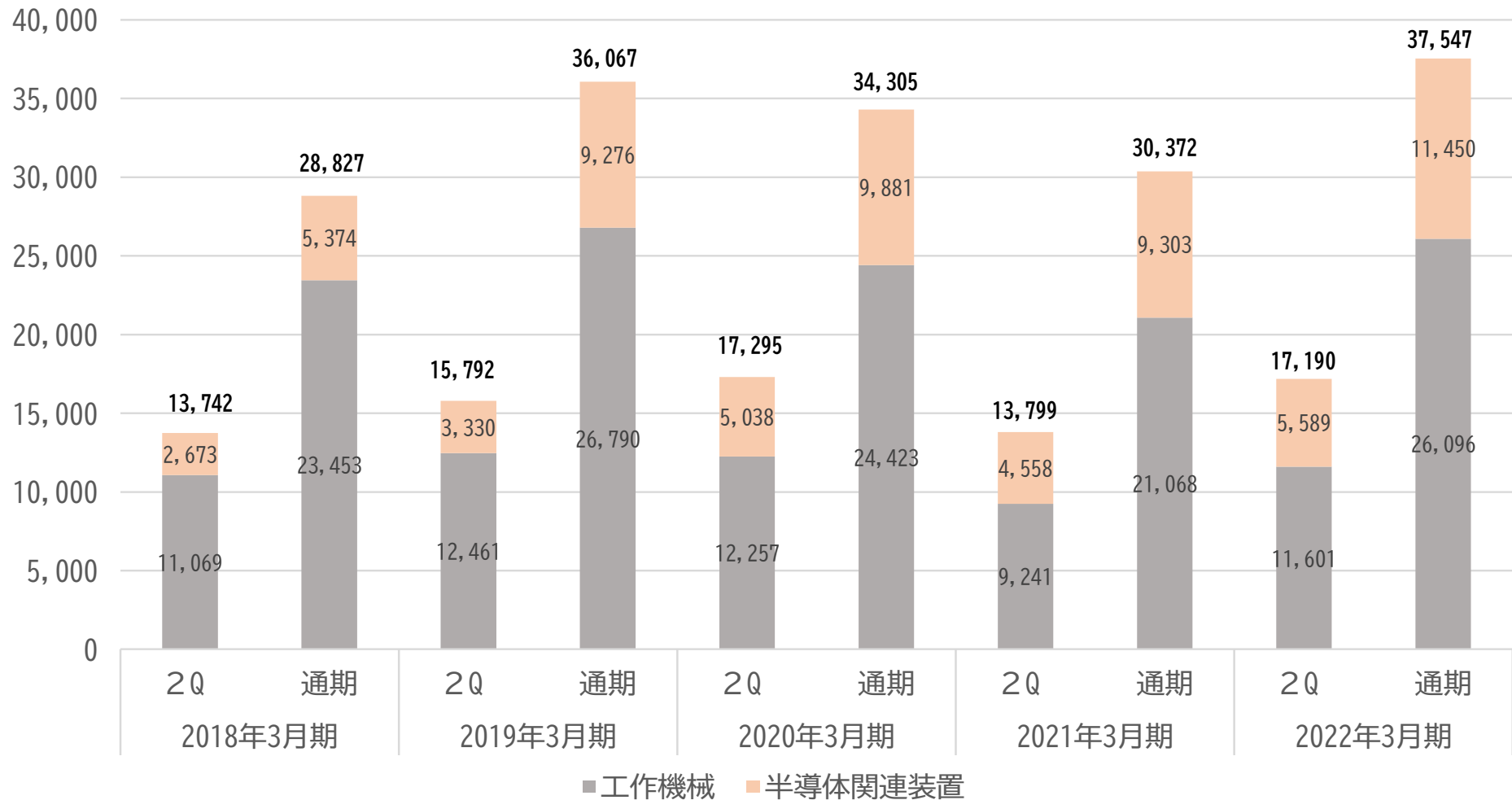
受注・受注残高

引き続き半導体中心に受注好調、工作機械も回復傾向。記録的な受注残高を抱えて新年度へ



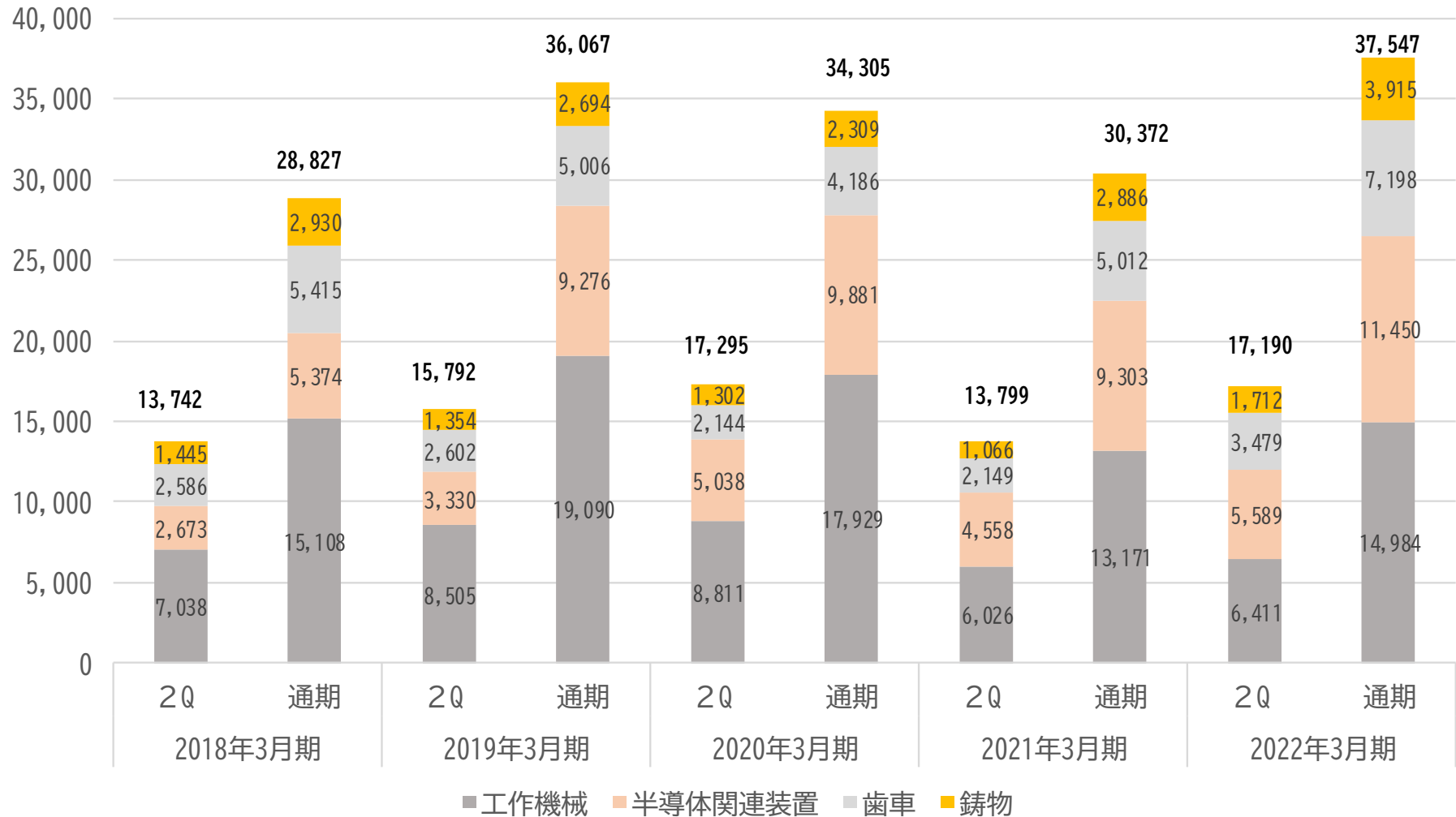
セグメント別売上高推移①

好調な設備投資需要に支えられ、過去最高の売上高を更新



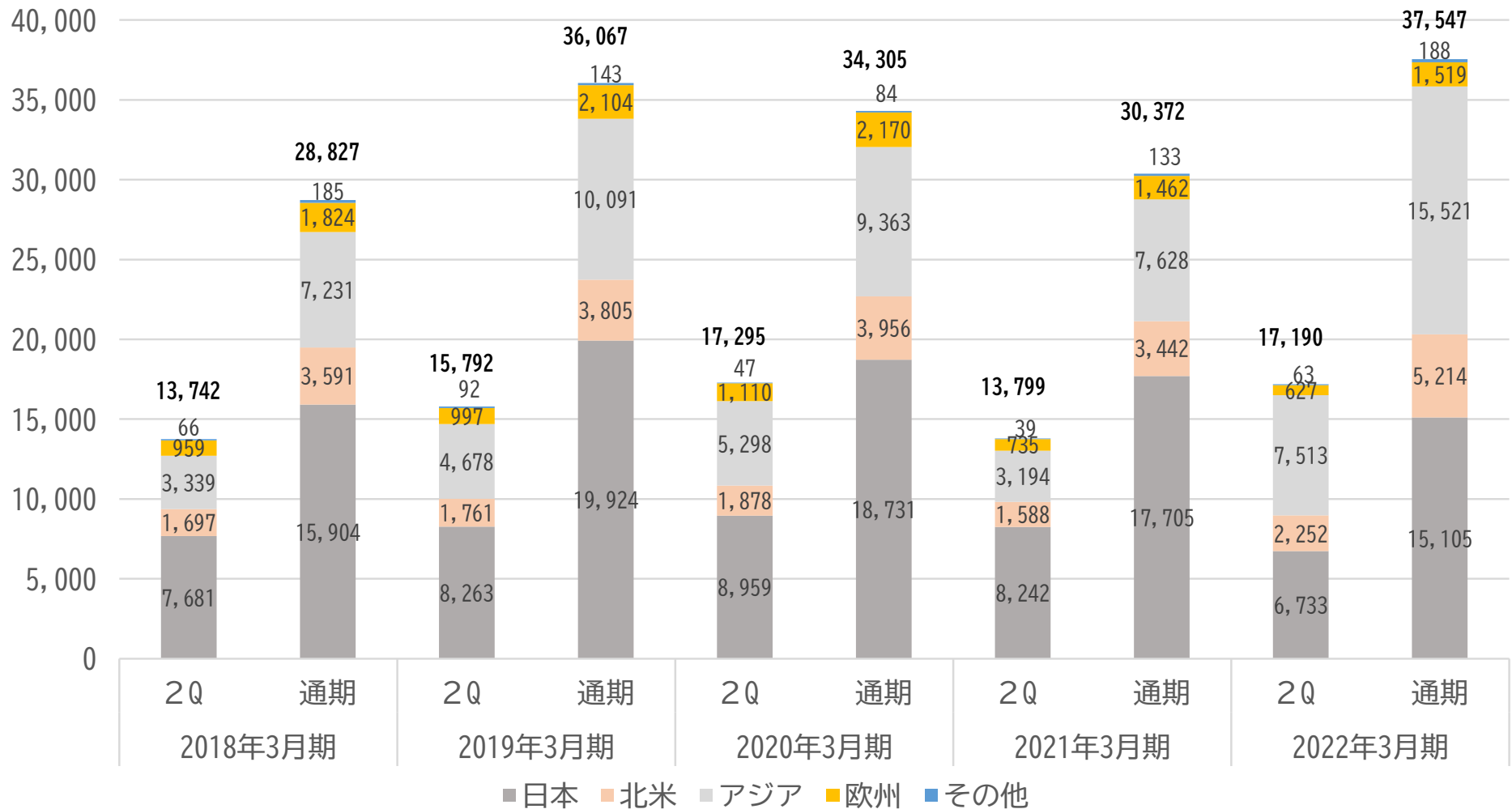
セグメント別売上高推移②

半導体だけでなくロボット需要などを受けて歯車も好調に推移



エリア別売上高推移

アジアでの売上増加が今期業績を牽引



比較貸借対照表

(単位：百万円)

| | 2021年3月 | 2022年3月 | |
|-----------|---------|---------|---------|
| | 金額 | 金額 | 対前期末比 |
| 流動資産 | 23,444 | 35,343 | +11,899 |
| 現金及び預金 | 4,925 | 7,333 | +2,408 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,391 | 8,114 | ▲1,277 |
| 棚卸資産 | 8,987 | 14,302 | +5,315 |
| 有形・無形固定資産 | 9,952 | 10,337 | +385 |
| 投資等 | 1,653 | 1,826 | +173 |
| 資産合計 | 35,050 | 47,507 | +12,457 |

(単位：百万円)

| | 2021年3月 | 2022年3月 | |
|--------|---------|---------|---------|
| | 金額 | 金額 | 対前期末比 |
| 負債合計 | 19,969 | 27,176 | +7,207 |
| 流動負債 | 16,832 | 24,493 | +7,661 |
| 固定負債 | 3,137 | 2,683 | ▲454 |
| 純資産合計 | 15,080 | 20,331 | +5,251 |
| 負債資本合計 | 35,050 | 47,507 | +12,457 |

比較キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

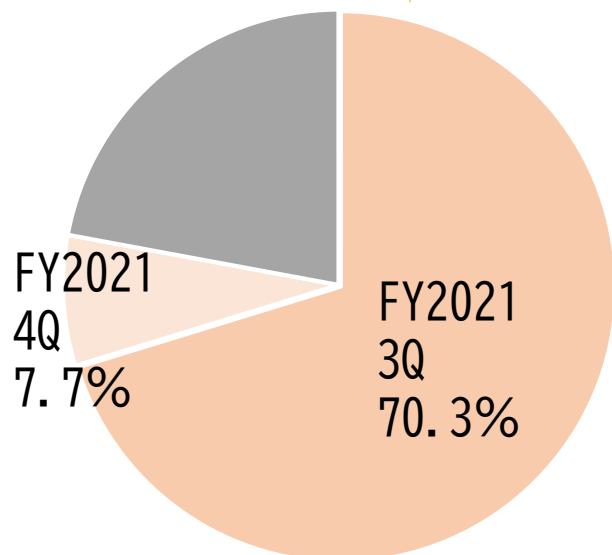
| | 2021年3月 | 2022年3月 | |
|------------------|---------|---------|----------|
| | 金額 | 金額 | 対前年同期比増減 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,922 | 11,668 | +5,746 |
| 税引前当期純利益 | 1,864 | 4,203 | +2,339 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,418 | +51 |
| 売上債権の増減（▲は増加） | ▲704 | 474 | +1,178 |
| 棚卸資産の増減（▲は増加） | 1,729 | ▲3,334 | ▲5,063 |
| 仕入債務の増減（▲は減少） | 401 | 2,356 | +1,955 |
| その他 | 1,295 | 6,551 | +5,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲919 | ▲1,547 | ▲628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲3,690 | ▲3,150 | +540 |
| 換算差額 | 153 | 268 | +115 |
| 現金・現金同等物残高 | 4,778 | 12,016 | +7,238 |

第三者割当による行使価格修正条項付新株予約権の行使状況

1. 生産能力向上に向けた設備投資及び中国子会社への投資資金
2. 本社工場における自動倉庫の建設に向け資金調達を実施

現状
85%行使

| | |
|---------|-----------------------|
| 調達予定先 | 大和証券株式会社 |
| 行使期間 | 2021年9月28日～2024年9月27日 |
| 新株予約権個数 | 7,000個 |
| 目的株式数 | 700,000株 |
| 当初行使価額 | 6,275円 |
| 下限行使価額 | 4,092円 |
| 想定調達額 | 4,429百万円(6,275円想定) |



| 行使期間 | 行使個数(個) | 交付株式数(株) | 調達額(百万円) |
|---------------------|---------|----------|----------|
| FY2021 3Q (10月～12月) | 4,918 | 491,800 | 2,231 |
| FY2021 4Q (1月～3月) | 536 | 53,600 | 222 |
| FY2022 1Q (4月～6月9日) | 493 | 49,300 | 203 |
| 計 | 5,947 | 594,700 | 2,656 |

2. 前中期経営計画 「SHINKA2022」 振り返り

総括 サマリ

前中計期間、
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたが、
「安定した収益を確保できる企業」を目指し、
各種施策に取り組む

特に半導体関連装置事業で追い風を受け、
最終的に売上高など当初目標に近い水準を達成

目標数値と最終実績

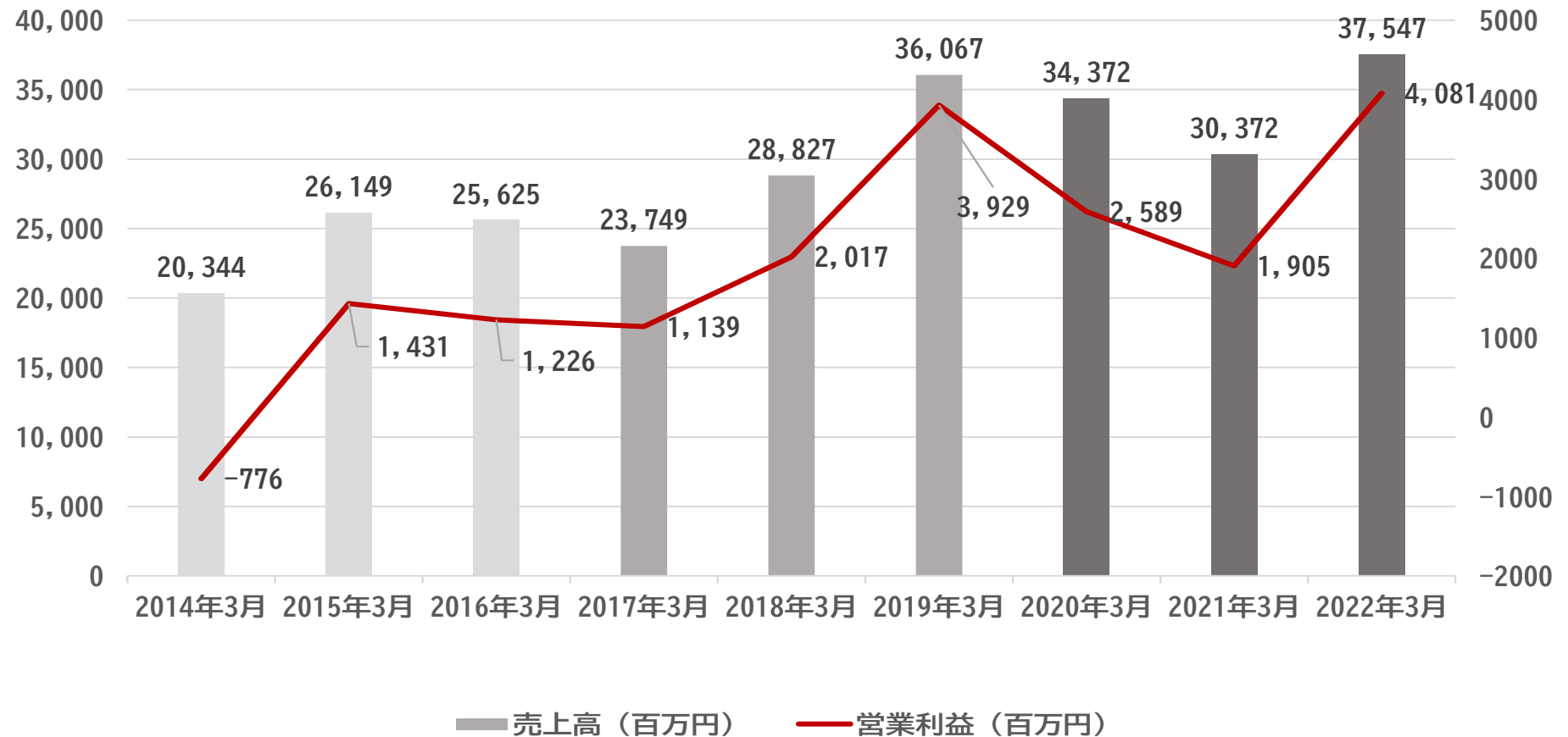
最終的に、売上高375億円、営業利益40億円、営業利益率10%を達成

| | 2022年3月期 (当初計画) | 2022年3月期 (修正計画) | 2022年3月期 (最終実績) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 連結売上高 | 380億円 | 340億円 | 375億円 |
| 連結営業利益 | 46億円 | 27.5億円 | 40億円 |
| 連結営業利益率 | 12% | 8% | 10% |

2021年5月13日公表

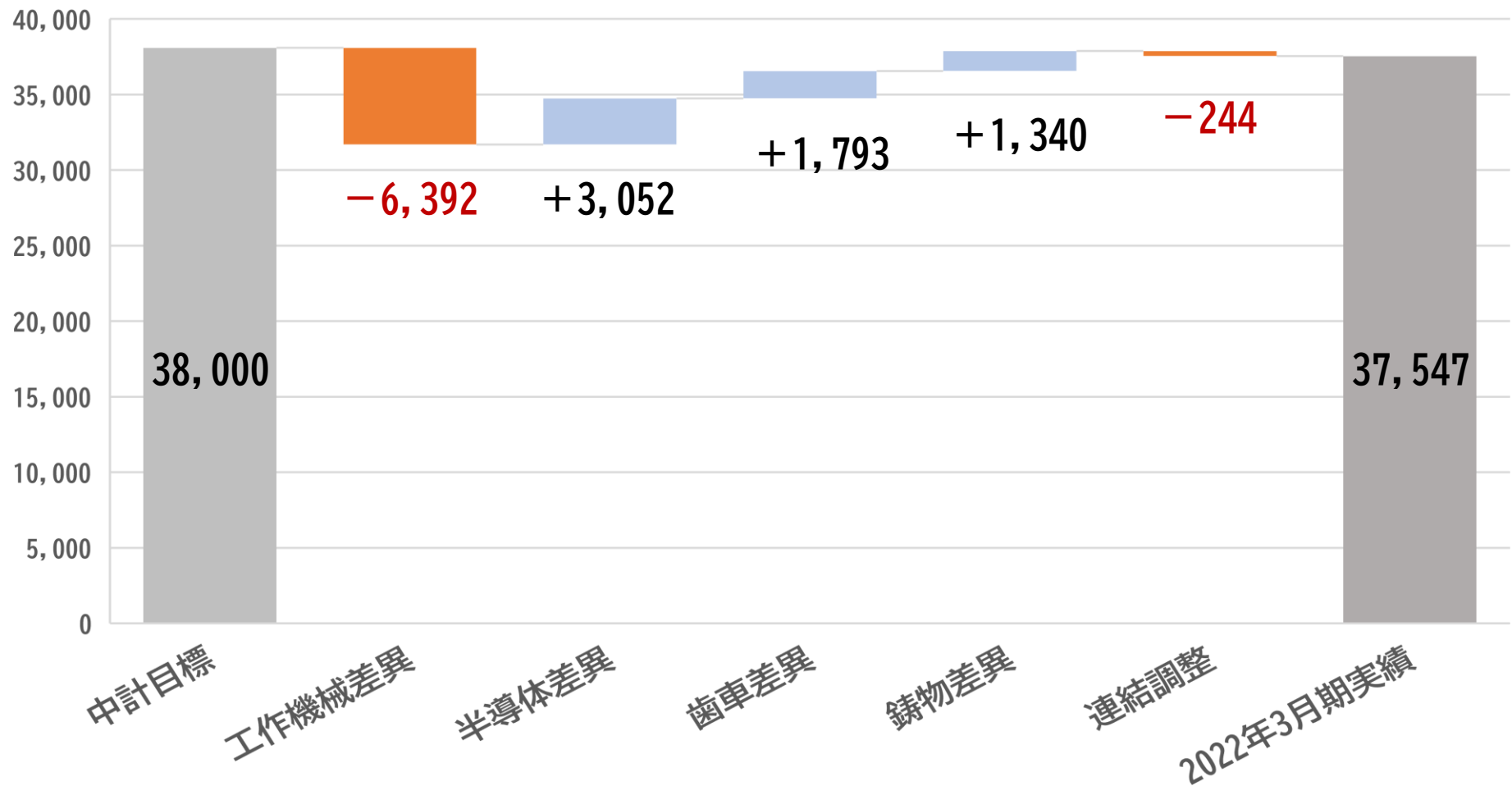
長期業績推移 売上高・営業利益推移

新型コロナウイルス感染症の影響を受けるも業績は回復局面に



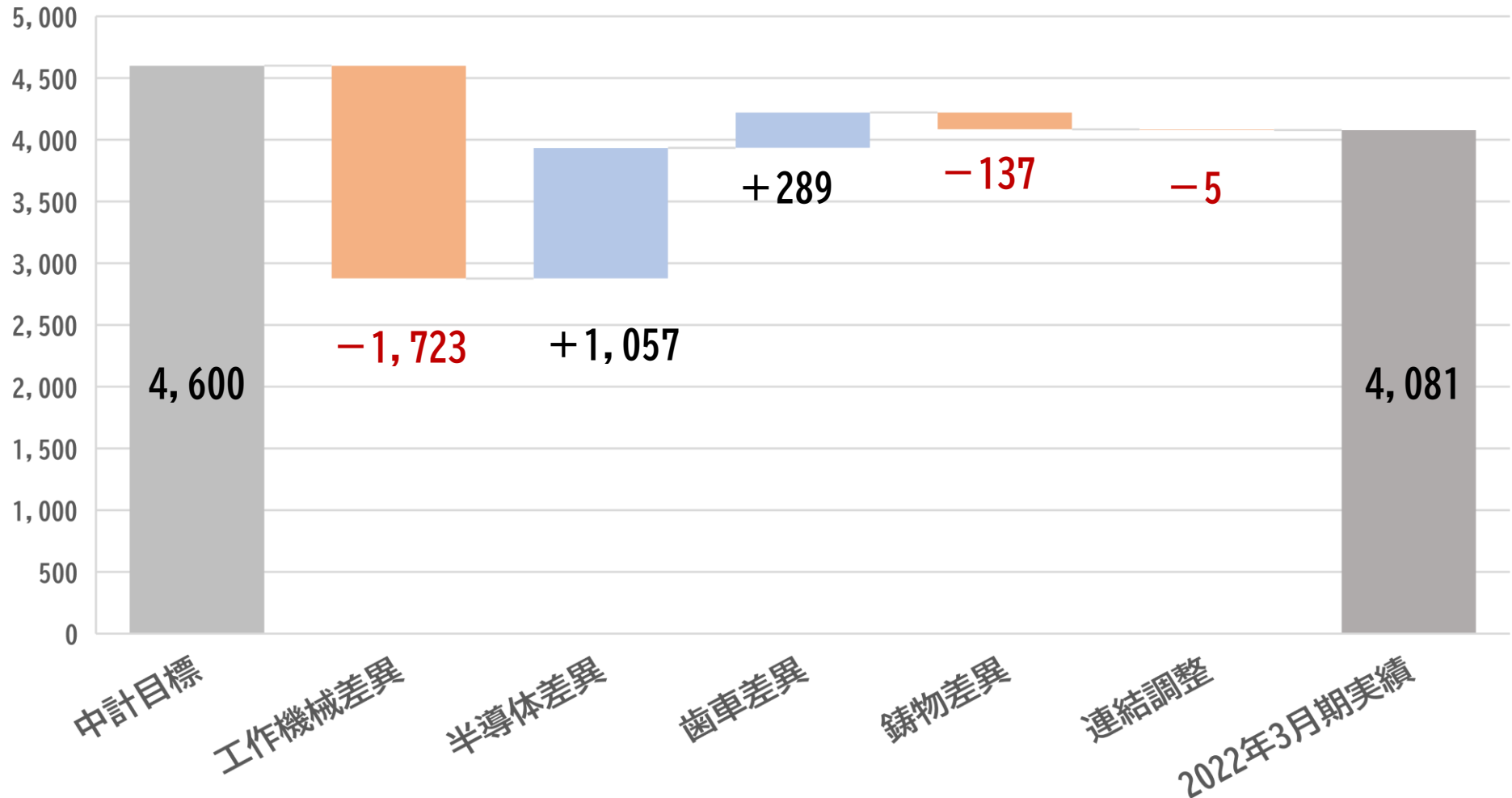
事業部門別売上高差異分析

当初計画に対してマクロ環境もあり工作機械が苦戦した分、半導体を中心に歯車・鋳物が健闘



事業部門別営業利益差異分析

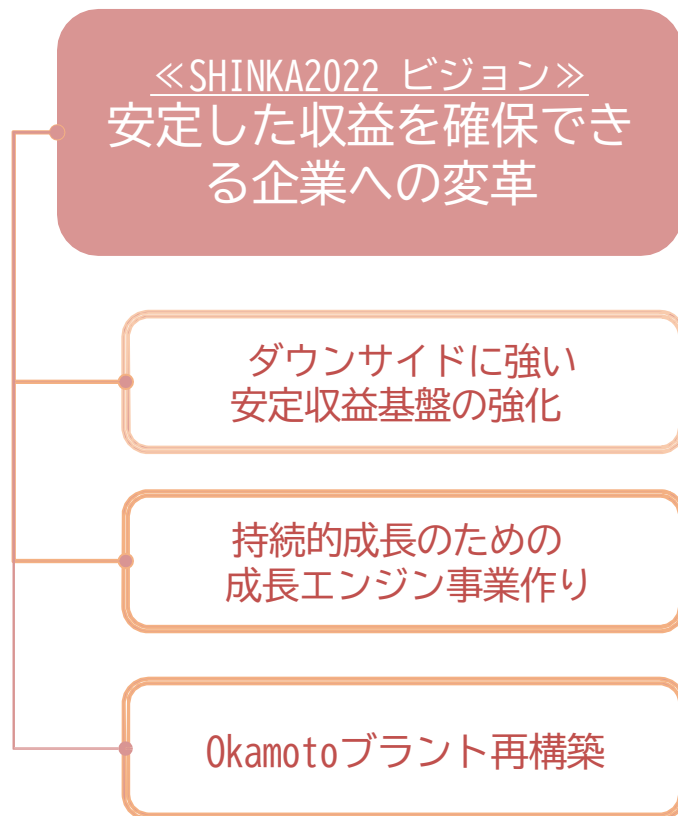
利益貢献についてはより半導体部門が牽引、歯車も中計後半から利益貢献を強める



SHINKA2022（前中計）ビジョンと3大戦略

前中計では「安定した収益を確保できる企業への変革」をビジョンとして掲げ、3大戦略を実行

▼SHINKA2022（前中計）ビジョン



▼SHINKA2022（前中計）3大戦略

1 顧客付加価値強化（B to BからB with Bへ）

- ✓ サービス体制拡充
- ✓ 高付加価値機拡販

2 グローバル戦線拡充

- ✓ マーケティング体制強化
- ✓ 管理体制強化

3 モノづくり改革

- ✓ モノづくりの整流化／QCD改善
- ✓ 海外直送体制の確立

実行した施策と今後の課題

| | 実行した施策 | 新中計に引き継ぐ課題 |
|------------------|--|---|
| サービス体制拡充 | <ul style="list-style-type: none"> CS本部を起ち上げ、保守サービスの新規開発等サービス体制を強化 | <ul style="list-style-type: none"> グローバルサービス体制（工作・半導体）は構築途上 サービス在庫の最適化（自動倉庫含む）顧客の省人化に寄与しつつ新サービス開発も道半ば |
| 高付加価値機 拡販 | <ul style="list-style-type: none"> 高付加価値機を重点機種に設定し、グローバルでの拡販を意識的に実施 | <ul style="list-style-type: none"> 全社損益に対する利益貢献は十分ではなく、高付加価値機の売上比率も向上余地あり |
| マーケティング 体制強化 | <ul style="list-style-type: none"> 商品企画部を新設し、デジタルマーケティング全般を推進 インド拠点開設 | <ul style="list-style-type: none"> 投資効率管理や機種統廃合等、製品ポートフォリオの最適化に関する取組については課題 |
| 管理体制強化 | <ul style="list-style-type: none"> 四半期毎のモニタリング（KPI・AP）が定着 | <ul style="list-style-type: none"> 部門・拠点毎に取組のレベル感に温度差 セグメント管理に課題 |
| モノづくり強化 QCD改善 | <ul style="list-style-type: none"> VE・直送化による変動費改善を開始、一定の成果 システム投資による業務効率化を検討し、導入・実装フェーズに移行 | <ul style="list-style-type: none"> VE・直送化共目標に対しては未達。方針・体制再構築必要 |

3. 新中期経営計画 概要


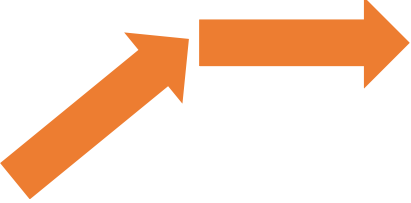


2022年度～2024年度

基本方針

「研削で価値を創造するソリューションカンパニーへ」

- 事業ポートフォリオを磨き研削・研磨の可能性を創造する
- 研削ソリューション・サービス等、顧客の価値を創造する
- サステナブル経営をもって、事業の持続的体制作りと持続的社会的実現に努力する

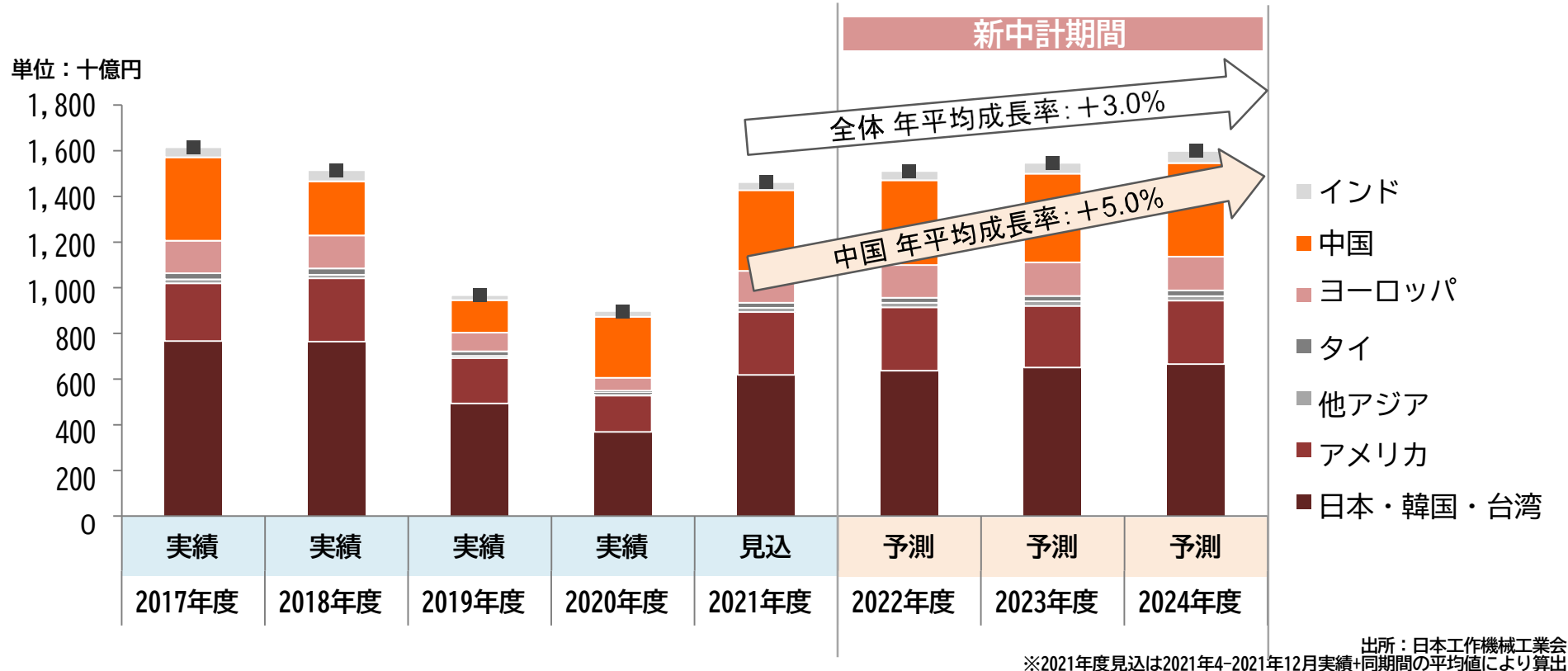
新中計期間における市場の要請

| | トレンド | 概要 |
|-------------------|---|---|
| 工作機械 | グローバル工作機械市場  | <ul style="list-style-type: none"> ● 顧客の省人化に寄与するサービス要求（自動化対応、IoTコネクテッド、高精度かつ容易な研削） ● 拡大する中国マーケットへの対応 ● 半導体やEVシフトに関連する業界での堅調な機械需要 ● 市場変動（市況悪化リスク）への対応 |
| 半導体 | 半導体ポリッシャー市場  | <ul style="list-style-type: none"> ● 5G社会の到来、IoTの普及等による長期的な半導体需要拡大トレンド ● 市場に存在する半導体製造設備の高稼働によるサービス需要の継続発生 ● 半導体市場での競合環境激化（次世代開発の背景） ● 中国市場での需要減少リスク |
| 精密部品・素材 （歯車） | グローバルロボット市場  | <ul style="list-style-type: none"> ● グローバルでの省人化ニーズ増加に伴うロボット需要増加 ● 主要顧客の中長期的な増産方針 ● 鋼材価格の変動リスク ● 主要顧客のロボット市場におけるシェア変動可能性 |
| 他、考慮すべき 社会トレンド |  | <ul style="list-style-type: none"> □ サステナビリティに関連する取組の強化（SDGs / ESG） □ 少子高齢化/労働人口減少への対応 |

工作機械マーケット展望

グローバルでの工作機械市場は年平均成長率+3.0%での成長を予測

▼各国向け 工作機械受注予測 (日工会受注統計をベースに当社主要地域の成長率を予測)

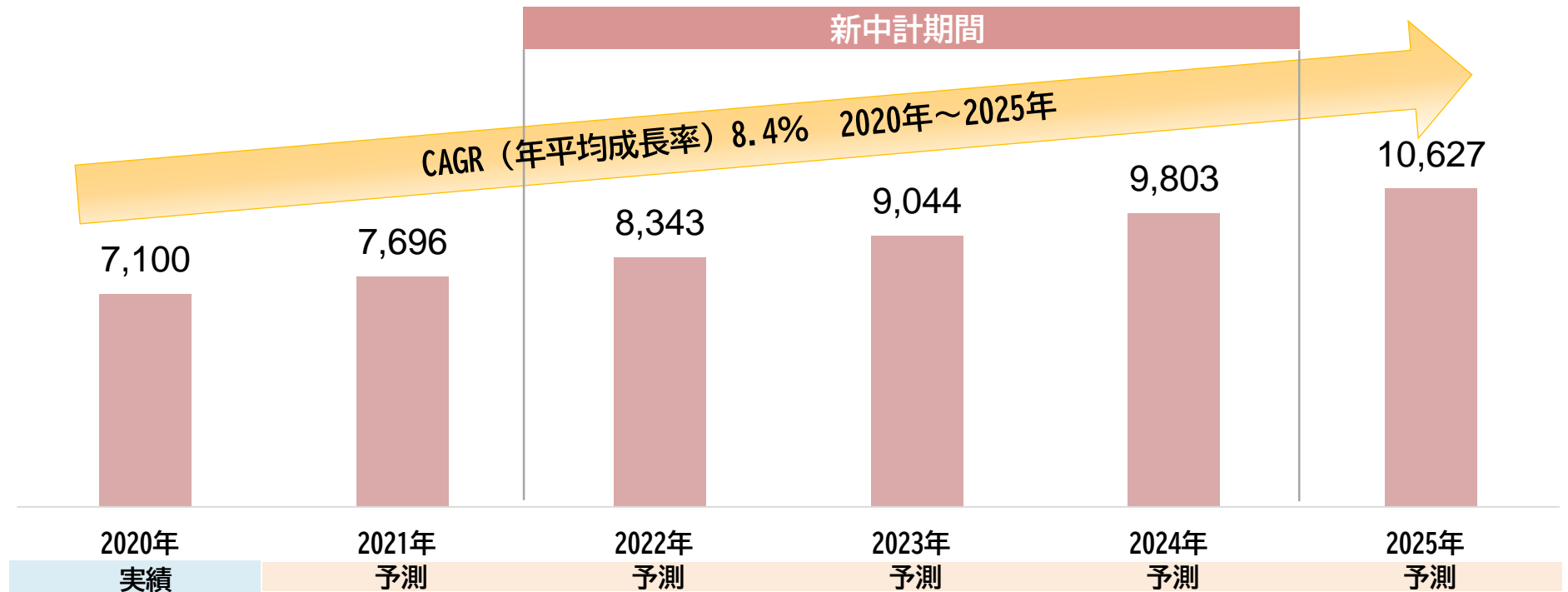


- ✓ グローバルでは、コロナ禍により落ち込んだ状況から回復
- ✓ 中国は日本に次ぐ需要規模であり、かつ2024年度まで継続的に5%程度の成長を見込む

半導体マーケット展望（シリコンウェハ関連）

5G社会の到来、IoTの普及等により、半導体需要は中・長期的に拡大トレンド

▼300 mm シリコンウェハ需要予測（千枚/月）



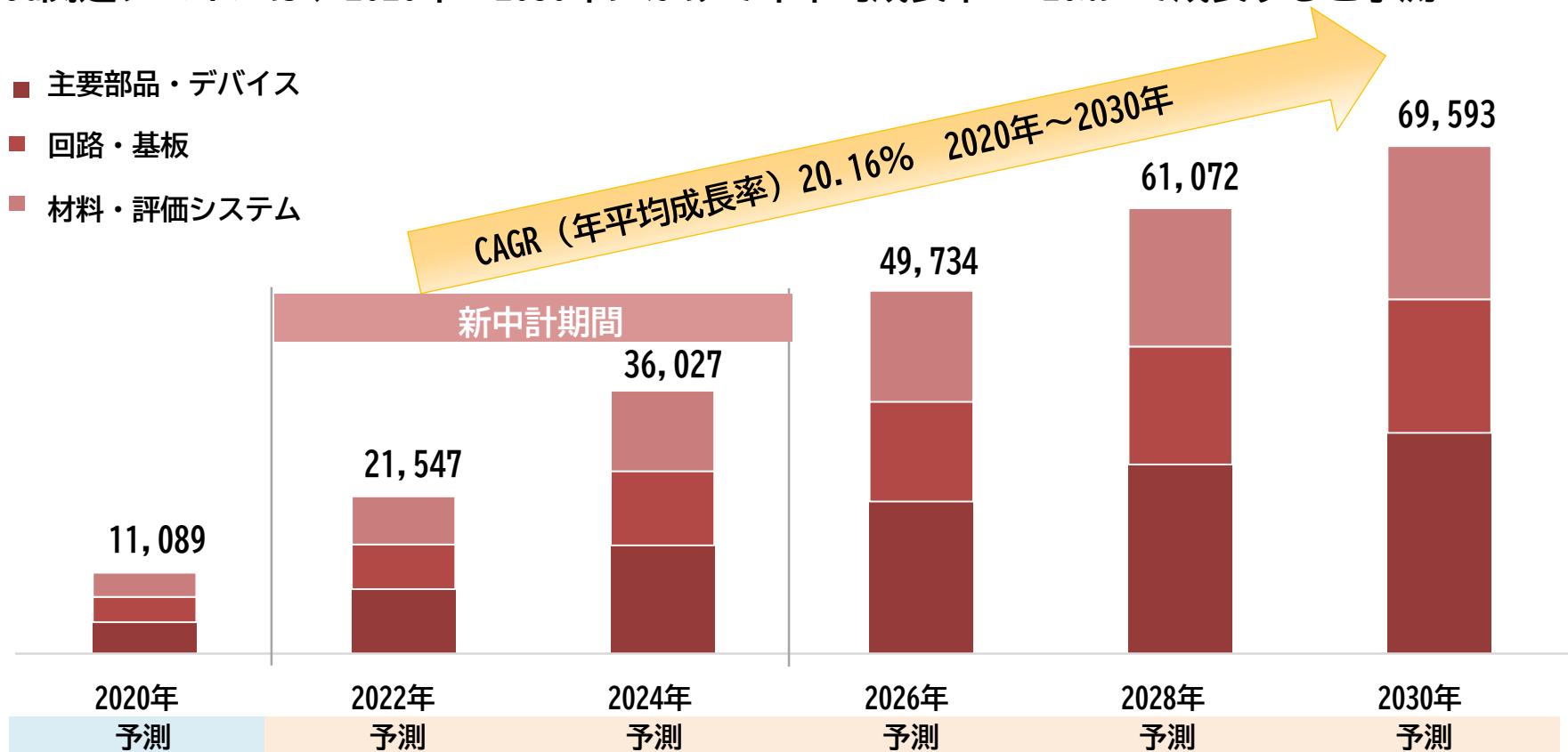
出所：”SUMCO四半期決算資料 3Q-2021 Resultsレポート”より当社作成

✓ 半導体市場は引き続き拡大傾向と予想されており、シリコンウェハ需要量も増加していく見込み

半導体マーケット展望（LT・LNウェハ関連）

5G関連デバイスは、2020年～2030年にかけて年平均成長率 +20%にて成長すると予測

- 主要部品・デバイス
- 回路・基板
- 材料・評価システム



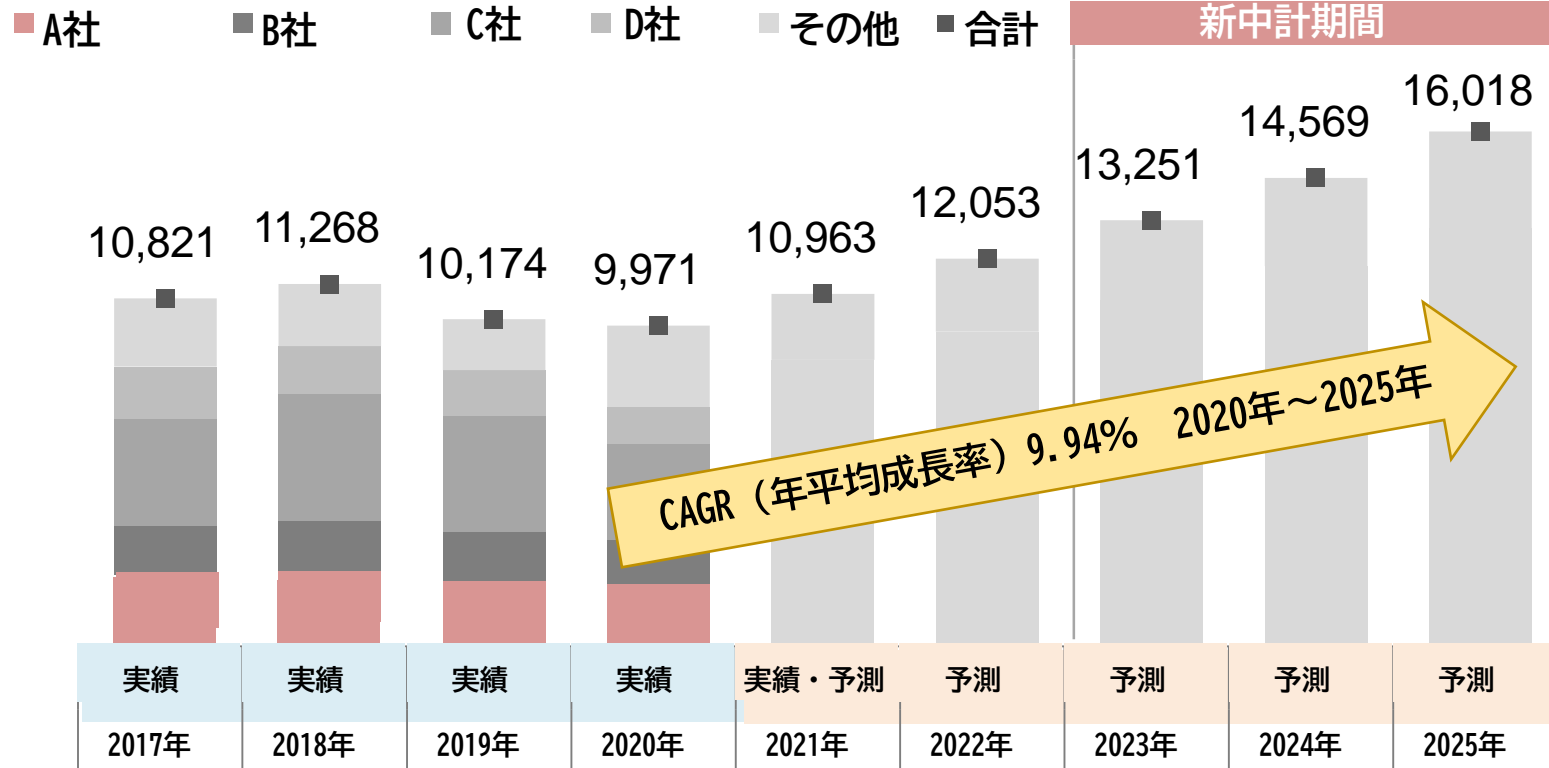
出所：矢野経済研究所 5G関連デバイスの現状と展望（2020）

✓ 5G関連デバイスの需要拡大に伴い、LT・LNウェハ向けポリッシャー需要も拡大する見込み

歯車マーケット展望

世界の製造業向けロボット市場は、2025年まで年平均成長率+10%での成長を見込む

▼製造業向けロボット世界市場（単位：億円）



- ✓ 製造業向けロボット市場は拡大トレンド
- ✓ 主要ロボットメーカーシェアは変動可能性あり

出所：富士経済「ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望」より

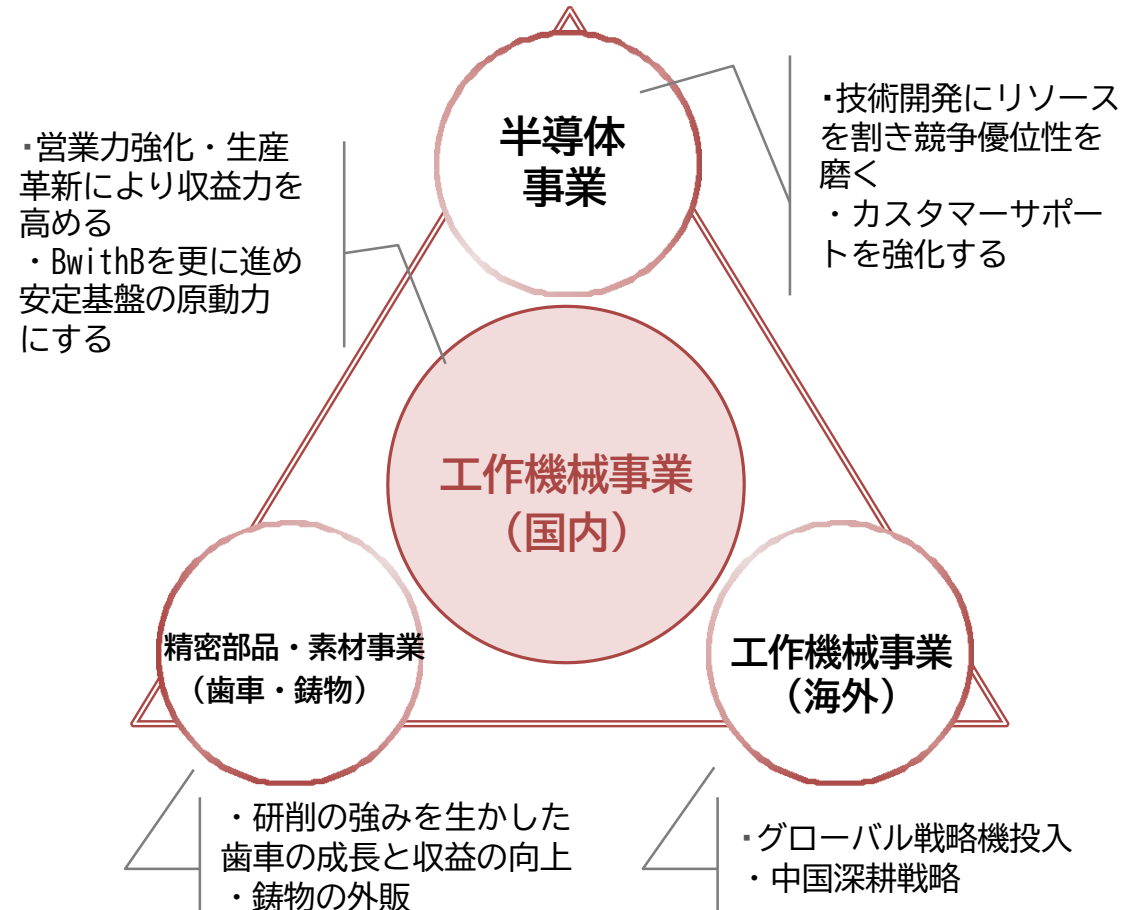
中計ビジョンと全社戦略ハイライト

中計ビジョン

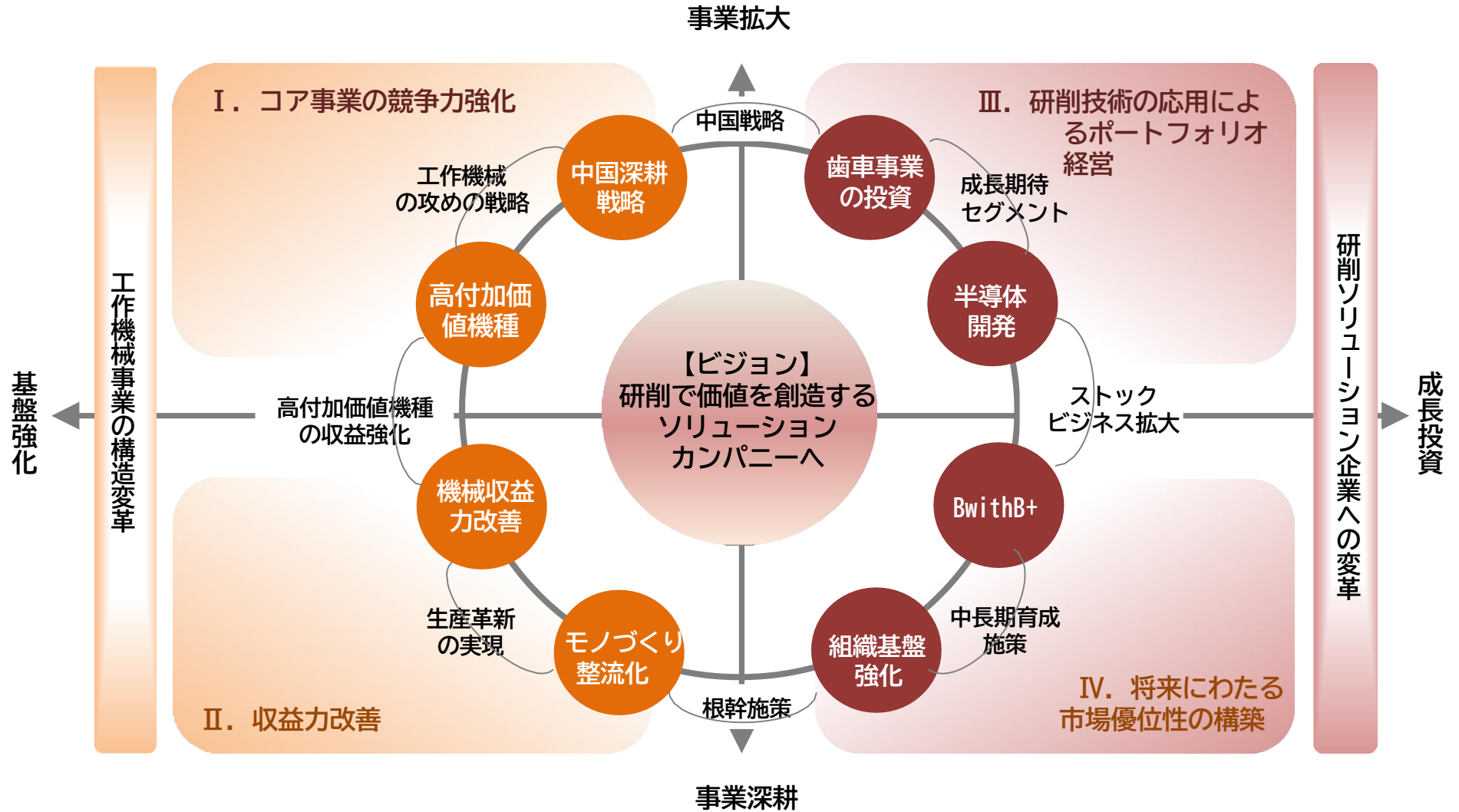
研削で価値を創造するソリューション企業へ

- ▶ 事業ポートフォリオを磨き研削・研磨の可能性を創造する
- ▶ 研削ソリューション・サービス等、顧客の価値を創造する
- ▶ サステナブル経営をもって、事業の持続的体制作りと持続的社会的実現に寄与する

全社戦略ハイライト



研削で価値を創造するソリューションカンパニーへ 中計重点戦略



中計重点戦略 戦略骨子

| | | | | 工作機械 | 半導体 | 精密部品・素材 | |
|-----------------|---------------------|----------|--|------|-----|---------|----|
| | | | | | | 歯車 | 鋳物 |
| 工作機械事業の構造改革 | コア事業の競争力強化 | 中国深耕戦略 | 中国市場でのマーケットシェア拡大 | ○ | | | |
| | | 高付加価値機種 | グローバルでの高付加価値機種拡販 ブランド価値向上 | ○ | | | |
| | 収益力改善 | 機械収益力改善 | 機械本体の収益性向上 (VE、マージン確保・改善、機種ポートフォリオの変更) | ○ | | | |
| | | モノづくり整流化 | 上流からのモノづくりの整流化 (QCD/OPS改善活動の融合、直販体制の確立、開発～販売計画の連動) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 研削ソリューション企業への変革 | 研削技術の応用によるポートフォリオ経営 | 歯車事業への投資 | 主要顧客向け新工場投資による増産 | | | ○ | |
| | | 半導体開発 | 戦略的な次世代機開発によるトップシェアの維持・拡大 | | ○ | | |
| | 将来に亘る市場優位性の確保 | BwithB+ | グローバルでの部品・サービスの拡販 顧客の省人化に寄与する自動化推進 | ○ | ○ | | |
| | | 組織基盤強化 | 新人事制度の構築・運用 サステナブル経営の推進 (技能伝承・次世代育成、社会の持続可能性の追求) | ○ | ○ | ○ | ○ |

サステナブル経営の推進

「社会の持続可能性」と「当社の持続的成長」を追求する当社にとってのサステナブル経営を推進

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

現在の取組状況

新中計での取組方針

事業戦略 による貢献

顧客の事業活動を支える工作機械の販売、オーバーホール機販売等、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に向けて貢献している

- 世の中のトレンドを踏まえた製品開発等、事業戦略と紐づいた主体的・積極的な取組を実施

組織戦略 による貢献

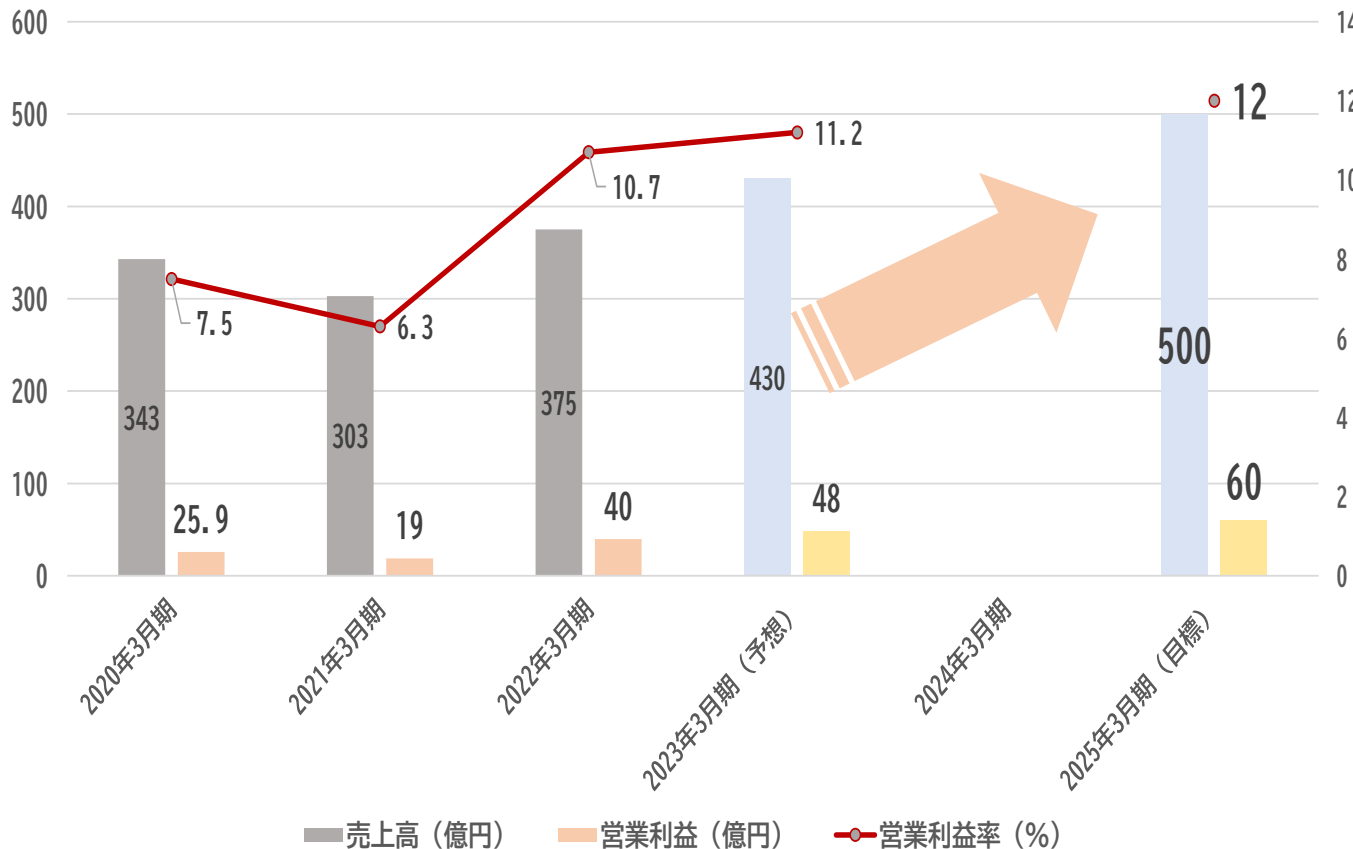
- 社員への教育機会の提供
- ガバナンス体制（各種法令の遵守）

- 組織基盤の構築を一層進め、当社自身としての持続可能性を追求（技能伝承、人事制度の再構築、生産管理システムの再構築、等）

（社会の持続可能性／自社の持続可能性）
サステナビリティの実現

数値目標

中計最終年度、売上高500億円、営業利益60億円、営業利益率12%を目指す



売上高
375億円 (2022年3月)
↓
500億円 (2025年3月)
CAGR 10.06%

営業利益
40億円 (2022年3月)
↓
60億円 (2025年3月)
CAGR 14.47%

4. 2023年3月期 決算予想

2023年3月期の市場環境見通し

■ 国内市場

- 工作機械はものづくり補助金や事業再構築補助金などの経済政策、またコロナ禍からの回復を受けた幅広い業界からの設備投資需要を予想
- 半導体は、5Gや社会全体のデジタル化の推進の流れのなか、引き続きこれらに対応する活発な設備投資需要を予想

■ 海外市場

- 北米市場は、コロナ後の景気回復を受け、引き続き半導体セラミックス、金型業界は好調を継続。また低迷していた航空機関連からも徐々に引き合いが増加
自動車関連は、半導体不足解消ができず、まだ大きな動きは無い
- 欧州はコロナ感染症の再拡大はあるものの、自動車産業などの設備投資増加を予想
- アジア市場では中国でのゼロコロナ対策による市場動向に注視するも、EV車関連、半導体関連など設備投資の増加を予想
東アジア、東南アジアでも半導体関連を中心に投資の増加を予想

通期業績予想

新中計初年度、豊富な受注残などを梃子に、売上高430億円、営業利益48億の達成を見込む

(単位：百万円)

| | (単位：百万円) | | |
|-------|----------|-----------------|-------|
| | 2022年3月 | 2023年3月 (予想) | |
| | 金額 | 金額 | 増減率 |
| 売上高 | 37,547 | 43,000 | 14.5% |
| 売上総利益 | 11,926 | 13,284 | 11.4% |
| 販管費 | 7,845 | 8,484 | 8.1% |
| 営業利益 | 4,081 | 4,800 | 17.6% |
| 経常利益 | 4,197 | 4,700 | 12.0% |
| 当期純利益 | 2,892 | 3,200 | 10.6% |

※小数点第2位を四捨五入

| | 2022年3月 | 2023年3月期 (予定) |
|----------|----------|------------------|
| | 金額 | 金額 |
| 設備投資額 | 1,536 | 3,214 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,478 |
| 研究開発費 | 95 | 131 |
| 為替レート | 2022年3月期 | 2023年3月期 (予想) |
| 米ドル | 113.04 | 110.00 |
| シンガポールドル | 83.83 | 82.00 |
| ユーロ | 131.11 | 130.00 |
| タイバーツ | 3.45 | 3.40 |
| 人民元 | 17.65 | 17.00 |

※期中の平均レートで記載しております。



Okamoto

Appendix

(ご参考資料)

世界唯一の総合砥粒加工機メーカー

会社概要

| | |
|-----------|---|
| 会社名 英文 | 株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd. |
| 創業 | 大正15年11月 |
| 設立 | 昭和10年6月 |
| 資本金 | 48億8051万円 |
| 本社所在地 | 〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地 |
| 事業内容 | <p>【工作機械・半導体関連装置の製造・販売】</p> <p>工作機械事業（平面研削盤・成形研削盤・内面研削盤・円筒研削盤・ 歯車研削盤・専用研削盤・精密歯車・鋳物）</p> <p>半導体関連装置事業（グライディングマシン・スライディングマシン・ホーリングマシン・ラッピングマシン・ガラス基板研磨装置）</p> |
| 従業員数 | 連結：1,984名 単体：455名 ※2022年3月末現在 |



事業概要

◎ 工作機械事業

汎用タイプから全自動CNCタイプまで多彩なラインナップを揃え、業界が求める研削・加工を研究・開発

◎ 半導体関連装置事業

各種半導体関連装置で半導体シリコンウェアをより薄く、より平らにする技術でモノ作りを支える

製品ラインナップ

工作機械



半導体関連装置

研削盤のシェア推計

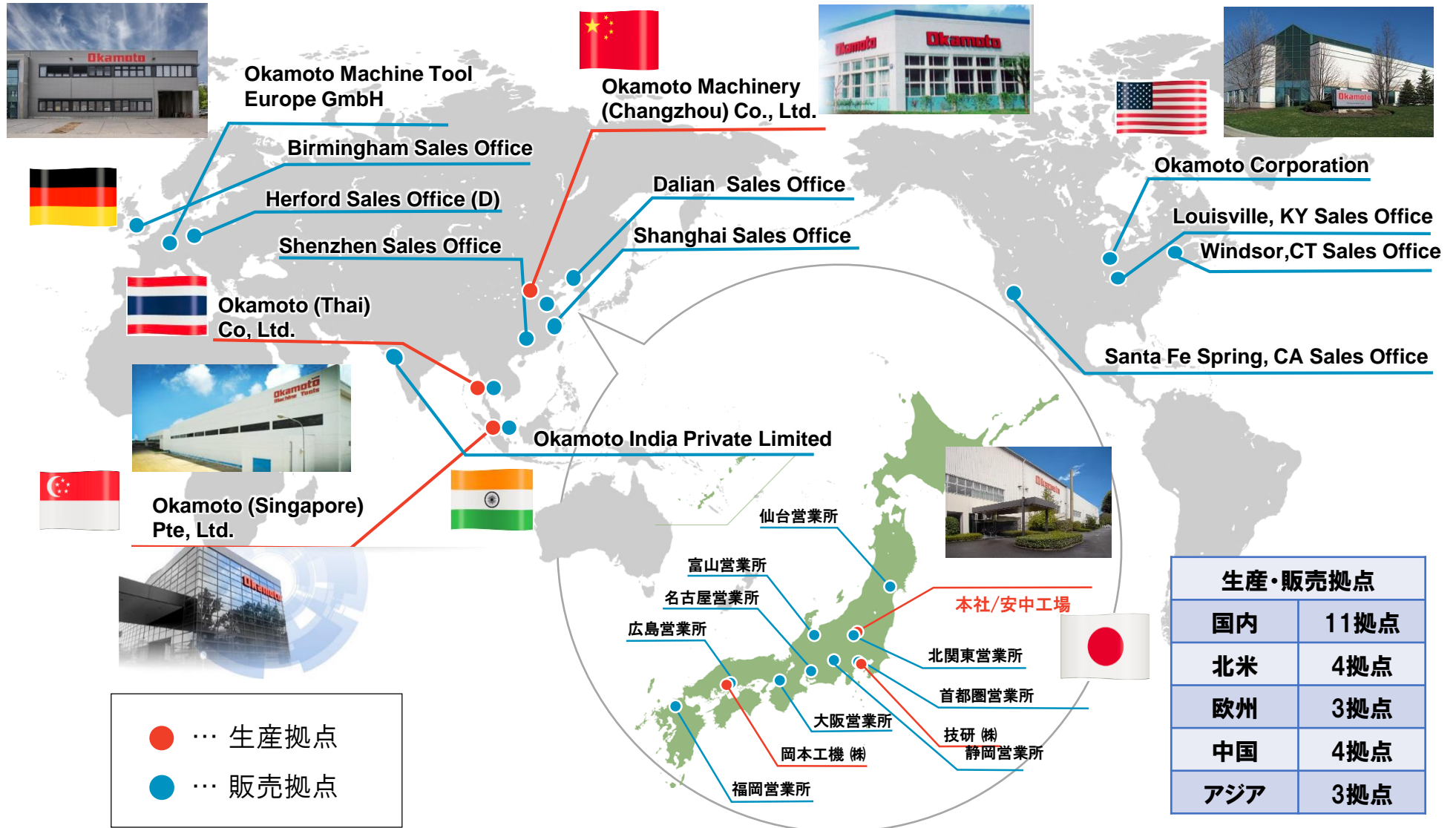
1953年生産開始以来69年

- 出荷台数：総計80,000台以上
- 出荷国数：世界約80カ国
- ユーザー数：世界20,000社以上
- 国内推計シェア：40%(当社推計)

※半導体製造装置は除く



国内拠点、海外拠点



本資料に関するお問い合わせ先

株式会社 岡本工作機械製作所
総務部
TEL 027(385)5800

【本資料お取り扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。